

2025-2030年中国半导体材料行业市场需求前景与投资规划分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：半导体材料行业概念界定及发展环境剖析

- 1.1 半导体材料的概念界定及统计口径说明
 - 1.1.1 半导体材料概念界定
 - 1.1.2 半导体材料的分类
 - (1) 前端制造材料
 - (2) 后端封装材料
 - 1.1.3 行业所属的国民经济分类
 - 1.1.4 本报告的数据来源及统计标准说明
- 1.2 半导体材料行业政策环境分析
 - 1.2.1 行业监管体系及机构
 - 1.2.2 行业规范标准
 - 1.2.3 行业发展相关政策汇总及重点政策解读（指导类/支持类/限制类）
 - (1) 行业发展相关政策/规划汇总
 - 1.2.4 行业重点规划/政策解读
 - (1) 国家层面
 - 1) “十四五”规划纲要
 - 2) 《国家集成电路产业发展推进纲要》
 - 3) 《“十四五”原材料工业发展规划》
 - 4) 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》
 - (2) 地方层面
 - 1.2.5 政策环境对行业发展的影响分析
- 1.3 半导体材料行业经济环境分析
 - 1.3.1 宏观经济现状
 - (1) 中国GDP及增长情况
 - (2) 中国三次产业结构
 - (3) 中国工业经济增长情况
 - (4) 中国固定资产投资情况
 - 1.3.2 经济转型升级发展分析（智能制造）
 - 1.3.3 宏观经济展望
 - (1) 国际机构对中国GDP增速预测
 - (2) 国内机构对中国宏观经济指标增速预测
 - 1.3.4 经济环境对行业发展的影响分析
- 1.4 半导体材料行业投资环境分析
 - 1.4.1 国家集成电路产业投资基金
 - (1) 大基金一期
 - (2) 大基金二期
 - 1.4.2 半导体材料行业投资、兼并与重组分析
 - (1) 半导体材料行业兼并与重组发展现状分析
 - 1) 半导体材料行业兼并与重组事件汇总
 - 2) 半导体材料行业兼并与重组动因分析
 - 3) 半导体材料行业兼并与重组趋势预判
 - (2) 半导体材料行业投融资事件分析
 - 1) 半导体材料行业资金来源
 - 2) 半导体材料行业投融资主体
 - 3) 半导体材料行业投融资事件汇总
 - 4) 半导体材料行业投融资信息汇总
 - 1.4.3 投资环境对行业发展的影响分析
- 1.5 半导体材料行业技术环境分析
 - 1.5.1 半导体行业技术迭代
 - 1.5.2 美国对中国半导体行业的相关制裁事件
 - 1.5.3 半导体材料行业技术发展趋势

- 1.5.4 技术环境对行业发展的影响分析
- 第2章：全球及中国半导体行业发展及半导体材料所处位置
- 2.1 全球半导体产业迁移历程分析
 - 2.1.1 全球半导体产业迁移路径总览
 - 2.1.2 阶段一：从美国向日本迁移
 - 2.1.3 阶段二：向韩国、中国台湾迁移
 - 2.1.4 阶段三：向中国大陆地区转移
 - 2.1.5 全球半导体产业发展总结分析
- 2.2 全球半导体行业发展现状分析
 - 2.2.1 全球半导体行业市场规模
 - 2.2.2 全球半导体行业需求竞争格局
 - 2.2.3 全球半导体行业产品竞争格局
 - 2.2.4 全球半导体行业区域竞争格局
- 2.3 中国半导体行业发展现状分析
 - 2.3.1 中国半导体行业市场规模
 - 2.3.2 中国半导体行业结构竞争格局
 - (1) 半导体行业细分市场结构
 - (2) 半导体设计环节规模
 - (3) 半导体制造环节规模
 - (4) 半导体封装测试环节规模
 - 2.3.3 中国半导体行业区域竞争格局
- 2.4 半导体材料与半导体行业的关联
 - 2.4.1 半导体材料在半导体产业链中的位置
 - 2.4.2 半导体材料对半导体行业发展的影响分析
- 2.5 全球及中国半导体行业发展前景及趋势分析
 - 2.5.1 半导体行业发展前景分析
 - (1) 全球半导体行业发展前景分析
 - (2) 中国半导体行业发展前景分析
 - 2.5.2 半导体行业发展趋势分析
 - (1) 全球半导体行业发展趋势分析
 - (2) 中国半导体行业发展趋势分析
- 第3章：全球半导体材料行业发展现状及前景分析
- 3.1 全球半导体材料行业发展现状分析
 - 3.1.1 全球半导体材料行业发展历程
 - 3.1.2 全球半导体材料行业市场规模
 - 3.1.3 全球半导体材料行业竞争格局
 - (1) 区域竞争格局
 - (2) 产品竞争格局
 - 1) 晶圆制造材料
 - 2) 封装材料
 - (3) 企业/品牌竞争格局
- 3.2 全球主要国家/地区半导体材料行业发展现状分析
 - 3.2.1 中国台湾地区半导体材料行业发展分析
 - (1) 半导体材料行业发展特点
 - (2) 半导体材料行业市场规模
 - (3) 半导体材料行业在全球的地位
 - 3.2.2 韩国半导体材料行业发展分析
 - (1) 半导体材料行业发展特点
 - (2) 半导体材料行业市场规模
 - (3) 半导体材料行业在全球的地位
 - 3.2.3 日本半导体材料行业发展分析
 - (1) 半导体材料行业发展特点
 - (2) 半导体材料行业市场规模
 - (3) 半导体材料行业在全球的地位
 - 3.2.4 北美半导体材料行业发展分析
 - (1) 半导体材料行业发展特点
 - (2) 半导体材料行业市场规模
 - (3) 半导体材料行业在全球的地位
- 3.3 全球半导体材料代表企业案例分析

- 3.3.1 日本揖斐电株式会社 (IBIDEN)
 - (1) 企业基本情况
 - (2) 企业经营情况
 - (3) 企业半导体材料业务布局
 - (4) 企业在华投资布局情况
- 3.3.2 日本信越化学工业株式会社
 - (1) 企业基本情况
 - (2) 企业经营情况
 - (3) 企业半导体材料业务布局
 - (4) 企业在华投资布局情况
- 3.3.3 日本株式会社SUMCO
 - (1) 企业基本情况
 - (2) 企业经营情况
 - (3) 企业半导体材料业务布局
 - (4) 企业在华投资布局情况
- 3.3.4 空气化工产品有限公司
 - (1) 企业基本情况
 - (2) 企业经营情况
 - (3) 企业半导体材料业务布局
 - (4) 企业在华投资布局情况
- 3.3.5 林德集团
 - (1) 企业基本情况
 - (2) 企业经营情况
 - (3) 企业半导体材料业务布局
 - (4) 企业在华投资布局情况
- 3.4 全球半导体材料行业发展前景及趋势
 - 3.4.1 全球半导体材料行业发展前景分析
 - 3.4.2 全球半导体材料行业发展趋势分析
- 第4章：中国半导体材料行业发展现状分析
 - 4.1 中国半导体材料行业发展概述
 - 4.1.1 中国半导体材料行业发展历程分析
 - 4.1.2 中国半导体材料行业市场规模分析
 - 4.1.3 中国半导体材料行业在全球的地位分析
 - 4.1.4 中国半导体材料行业企业竞争格局
 - 4.2 中国半导体材料行业进出口分析
 - 4.2.1 中国半导体材料行业进出口市场分析
 - 4.2.2 中国半导体材料行业进口分析
 - (1) 行业进口贸易规模
 - (2) 行业进口产品结构
 - 4.2.3 中国半导体材料行业出口分析
 - (1) 行业出口贸易规模
 - (2) 行业出口产品结构
 - 4.3 中国半导体材料行业波特五力模型分析
 - 4.3.1 现有竞争者之间的竞争
 - 4.3.2 供应商议价能力分析
 - 4.3.3 消费者议价能力分析
 - 4.3.4 行业潜在进入者分析
 - 4.3.5 替代品风险分析
 - 4.3.6 竞争情况总结
 - 4.4 中国半导体材料行业发展痛点分析
 - 4.4.1 半导体材料核心需求不足
 - 4.4.2 半导体材料对外依存度大
 - 4.4.3 半导体材料上下游联动不足
- 第5章：中国半导体材料行业细分市场分析
 - 5.1 中国半导体材料应用及细分市场构成分析
 - 5.1.1 半导体材料在半导体制造中的应用
 - 5.1.2 半导体材料细分市场现状
 - (1) 中国半导体材料细分市场结构
 - (2) 中国晶圆制造材料细分产品规模

(3) 中国封装材料细分产品规模

5.2 中国半导体材料（前端晶圆制造材料）发展现状及趋势分析

5.2.1 中国半导体硅片发展现状及趋势分析

- (1) 半导体硅片工艺概述
- (2) 半导体硅片技术发展分析
- (3) 半导体硅片发展现状分析
 - 1) 半导体硅片发展历程
 - 2) 半导体硅片供给情况
 - 3) 中国半导体硅片市场规模
- (4) 半导体硅片竞争格局
- (5) 半导体硅片国产化现状
- (6) 半导体硅片发展趋势分析

5.2.2 中国电子特气发展现状及趋势分析

- (1) 电子特气工艺概述
- (2) 电子特气技术发展分析
- (3) 电子特气发展现状分析
 - 1) 电子特气发展历程
 - 2) 电子特气产能
 - 3) 电子特气市场规模
- (4) 电子特气竞争格局
- (5) 电子特气国产化现状
 - 1) 政策扶持
 - 2) 已实现国产化产品
 - 3) 产品国产化率
- (6) 电子特气发展趋势分析

5.2.3 中国光掩膜版发展现状及趋势分析

- (1) 光掩膜版工艺概述
- (2) 光掩膜版技术发展分析
- (3) 光掩膜版发展现状分析
 - 1) 光掩膜版产能分布
 - 2) 光掩膜版市场规模
- (4) 光掩膜版竞争格局
- (5) 光掩膜版国产化现状
- (6) 光掩膜版发展趋势分析

5.2.4 中国光刻胶及配套材料发展现状及趋势分析

- (1) 光刻胶及配套材料工艺概述
- (2) 光刻胶及配套材料技术发展分析
- (3) 光刻胶及配套材料发展现状分析
 - 1) 光刻胶及配套材料发展历程
 - 2) 光刻胶及配套材料市场规模
- (4) 光刻胶及配套材料竞争格局
- (5) 光刻胶及配套材料国产化现状
- (6) 光刻胶及配套材料发展趋势分析

5.2.5 中国抛光材料发展现状及趋势分析

- (1) 抛光材料工艺概述
- (2) 抛光材料技术发展分析
- (3) 抛光材料发展现状分析
 - 1) 抛光材料发展历程
 - 2) 抛光材料市场规模
- (4) 抛光材料竞争格局
- (5) 抛光材料国产化现状
- (6) 抛光材料发展趋势分析

5.2.6 中国湿电子化学品发展现状及趋势分析

- (1) 湿电子化学品工艺概述
- (2) 湿电子化学品技术发展分析
- (3) 湿电子化学品发展现状分析
 - 1) 湿电子化学品发展历程
 - 2) 湿电子化学品市场规模
- (4) 湿电子化学品竞争格局

- (5) 湿电子化学品国产化现状
- (6) 湿电子化学品发展趋势分析
- 5.2.7 中国靶材发展现状及趋势分析
 - (1) 靶材工艺概述
 - (2) 靶材技术发展分析
 - (3) 靶材发展现状分析
 - 1) 靶材发展历程
 - 2) 靶材市场规模
 - (4) 靶材竞争格局
 - (5) 靶材国产化现状
 - (6) 靶材发展趋势分析
- 5.3 中国半导体材料（后端封装材料）发展现状及趋势分析
 - 5.3.1 中国封装基板发展现状及趋势分析
 - (1) 封装基板工艺概述
 - (2) 封装基板技术发展分析
 - (3) 封装基板发展现状分析
 - 1) 封装基板发展历程
 - 2) 封装基板市场规模
 - (4) 封装基板竞争格局
 - (5) 封装基板国产化现状
 - (6) 封装基板发展趋势分析
 - 5.3.2 中国引线框架发展现状及趋势分析
 - (1) 引线框架工艺概述
 - (2) 引线框架技术发展分析
 - (3) 引线框架发展现状分析
 - 1) 引线框架发展历程
 - 2) 引线框架市场规模
 - (4) 引线框架竞争格局
 - (5) 引线框架国产化现状
 - (6) 引线框架发展趋势分析
 - 5.3.3 中国键合线发展现状及趋势分析
 - (1) 键合线工艺概述
 - (2) 键合线技术发展分析
 - (3) 键合线发展现状分析
 - 1) 键合线需求现状
 - 2) 键合线市场规模
 - (4) 键合线竞争格局
 - (5) 键合线国产化现状
 - (6) 键合线发展趋势分析
 - 5.3.4 中国塑封料发展现状及趋势分析
 - (1) 塑封料工艺概述
 - (2) 塑封料技术发展分析
 - (3) 塑封料市场规模分析
 - (4) 塑封料竞争格局
 - (5) 塑封料国产化现状
 - (6) 塑封料发展趋势分析
 - 5.3.5 中国陶瓷封装材料发展现状及趋势分析
 - (1) 陶瓷封装材料工艺概述
 - (2) 陶瓷封装材料技术发展分析
 - (3) 陶瓷封装材料市场规模分析
 - (4) 陶瓷封装材料竞争格局
 - (5) 陶瓷封装材料国产化现状
 - (6) 陶瓷封装材料发展趋势分析

第6章：中国半导体材料行业领先企业生产经营分析

- 6.1 半导体材料行业代表企业概况
 - 6.1.1 代表企业概况
 - 6.1.2 代表企业半导体材料产品布局
 - 6.1.3 代表企业营收、毛利率等对比
- 6.2 半导体材料行业代表性企业案例分析

6.2.1 天津中环半导体股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
 - 1) 企业业务结构
 - 2) 企业销售网络
- (4) 企业半导体材料业务布局
- (5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

6.2.2 上海硅产业集团股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
 - 1) 企业业务结构
 - 2) 企业销售网络
- (4) 企业半导体材料业务布局
- (5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

6.2.3 浙江金瑞泓科技股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
 - 1) 企业业务结构
 - 2) 企业销售网络
- (4) 企业半导体材料业务布局
- (5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

6.2.4 有研新材料股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
 - 1) 企业业务结构
 - 2) 企业销售网络
- (4) 企业半导体材料业务布局
- (5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

6.2.5 福建阿石创新材料股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
 - 1) 企业业务结构
 - 2) 企业销售网络
- (4) 企业半导体材料业务布局
- (5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

6.2.6 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
 - 1) 企业业务结构
 - 2) 企业销售网络
- (4) 企业半导体材料业务布局
- (5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

6.2.7 湖北鼎龙控股股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
 - 1) 企业业务结构

- 2) 企业销售网络
 - (4) 企业半导体材料业务布局
 - (5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
 - (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析
- 6.2.8 安集微电子科技（上海）股份有限公司**
- (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业经营状况分析
 - (3) 企业业务结构及销售网络
 - 1) 企业业务结构
 - 2) 企业销售网络
 - (4) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
 - (5) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析
- 6.2.9 江苏雅克科技股份有限公司**
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构分析
 - (4) 企业销售渠道与网络分析
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.10 苏州金宏气体股份有限公司**
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构分析
 - (4) 公司气体供应模式分析
 - (5) 企业销售渠道与网络分析
 - (6) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.11 广东华特气体股份有限公司**
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构分析
 - (4) 企业气体供应模式分析
 - 1) 气瓶模式
 - 2) 槽车模式
 - (5) 企业销售渠道与网络分析
 - (6) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.12 广东光华科技股份有限公司**
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构分析
 - (4) 企业销售渠道与网络分析
 - (5) 企业发展优劣势分析
- 6.2.13 江阴江化微电子材料股份有限公司**
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构分析
 - 1) 超净高纯试剂业务
 - 2) 光刻胶配套试剂业务
 - (4) 企业销售渠道与网络分析
 - (5) 企业发展优劣势分析
- 6.2.14 江苏南大光电材料股份有限公司**
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构分析
 - 1) MO源产品业务
 - 2) 半导体前驱体产品业务
 - 3) 电子特气产品业务
 - 4) ArF光刻胶
 - (4) 企业销售渠道与网络分析
 - (5) 企业发展优劣势分析
- 6.2.15 宁波江丰电子材料股份有限公司**

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业销售渠道与网络分析
- (5) 企业发展优劣势分析

6.2.16 台湾欣兴电子股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业在大陆投资布局情况

第7章：中国半导体材料行业市场前瞻及投资策略建议

7.1 中国半导体材料行业市场前瞻

- 7.1.1 半导体材料行业生命周期判断
- 7.1.2 半导体材料行业发展潜力评估
- 7.1.3 半导体材料行业前景预测

7.2 中国半导体材料行业投资特性

- 7.2.1 行业进入壁垒分析
- 7.2.2 行业退出壁垒分析
- 7.2.3 行业投资风险预警

7.3 中国半导体材料行业投资价值与投资机会

- 7.3.1 行业投资价值评估
- 7.3.2 行业投资机会分析

7.4 中国半导体材料行业投资策略与可持续发展建议

- 7.4.1 行业投资策略与建议
- 7.4.2 行业可持续发展建议

图表目录

- 图表1：半导体前端制造材料分类及主要用途
- 图表2：半导体后端封装材料分类及主要用途
- 图表3：半导体材料行业所属的国民经济分类
- 图表4：报告的研究方法及数据来源说明
- 图表5：中国半导体材料行业监管体制
- 图表6：截至2024年中国半导体材料标准汇总
- 图表7：截至2024年半导体材料行业发展主要政策汇总
- 图表8：《国家集成电路产业发展推进纲要》政策解读与规划
- 图表9：碳基材料纳入《“十四五”原材料工业发展规划》意义
- 图表10：《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》政策解读
- 图表11：“十四五”期间中国31省市半导体行业政策规划汇总及解读
- 图表12：政策环境对中国半导体行业发展的影响总结
- 图表13：2012-2024年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）
- 图表14：2012-2024年中国三次产业结构（单位：%）
- 图表15：2012-2024年中国全部工业增加值及增速（单位：万亿元，%）
- 图表16：2012-2024年中国固定资产投资额（不含农户）及增速（单位：万亿元，%）
- 图表17：截至2024年全国智能制造能力成熟度自诊断企业分布（单位：家）
- 图表18：截至2024年全国智能制造能力成熟度水平（单位：%、家）
- 图表19：部分国际机构对2023年中国GDP增速的预测（单位：%）
- 图表20：2017-2024年中国GDP与半导体材料行业营收规模相关性
- 图表21：中国大基金一期半导体材料投资标的（单位：亿元，%）
- 图表22：中国大基金二期投资布局规划
- 图表23：截至2024年中国大基金二期投资领域分布（单位：%）
- 图表24：截至2024年中国大基金二期投资项目汇总（单位：亿元，%）
- 图表25：2018-2024年中国半导体材料行业并购交易案汇总（单位：%）
- 图表26：中国半导体行业兼并与重组类型和动因分析
- 图表27：半导体材料行业资金来源分析
- 图表28：中国半导体材料行业投融资主体分析

- 图表29: 2022-2024年中国半导体材料行业投融资事件汇总
- 图表30: 2014-2024年中国半导体材料行业投融资事件情况分析 (单位: 件, 亿元)
- 图表31: 截至2024年中国半导体材料行业投融资轮次分布 (单位: %)
- 图表32: 半导体行业技术迭代历程
- 图表33: 截至2024年美国对中国半导体行业制裁发展历程
- 图表34: 截至2024年美国对中国半导体行业的相关制裁事件汇总
- 图表35: 国内半导体晶圆制造材料产业发展趋势
- 图表36: 国内半导体封装材料产品发展趋势
- 图表37: 全球半导体产业迁移路径图
- 图表38: 全球半导体产业迁移结构
- 图表39: 全球半导体产业发展格局分析
- 图表40: 2013-2024年全球半导体产业市场规模及预测 (单位: 亿美元, %)
- 图表41: 2020-2024年全球推动未来一年内半导体公司收入增长的应用领域
- 图表42: 2017-2024年全球半导体行业细分市场结构 (单位: 亿美元)
- 图表43: 2021-2024年全球半导体行业细分市场份额 (单位: %)
- 图表44: 2021-2024年全球半导体行业地区分布 (单位: %)
- 图表45: 2017-2024年中国集成电路行业销售额 (单位: 亿元, %)
- 图表46: 2013-2024年中国集成电路行业细分领域销售额占比情况 (单位: %)
- 图表47: 2017-2024年中国集成电路设计业销售额和增长情况 (单位: 亿元, %)
- 图表48: 2017-2024年中国集成电路制造业销售额和增长情况 (单位: 亿元, %)
- 图表49: 2017-2024年中国集成电路封装测试业销售额及增长情况 (单位: 亿元, %)
- 图表50: 2013-2024年中国集成电路产量和增速情况 (单位: 亿块, %)
- 图表51: 2024年中国集成电路累计产量TOP10省市 (单位: %)
- 图表52: 半导体产业链
- 图表53: 2013-2024年全球半导体材料市场规模占半导体市场规模比重情况 (单位: %)
- 图表54: 2025-2030年全球半导体行业市场规模预测 (单位: 亿美元)
- 图表55: 2025-2030年中国集成电路行业销售额预测 (单位: 亿元)
- 图表56: 全球半导体行业发展趋势分析
- 图表57: 中国半导体行业发展趋势分析
- 图表58: 全球半导体材料行业发展历程
- 图表59: 2013-2024年全球半导体材料市场规模及其增长情况 (单位: 亿美元, %)
- 图表60: 2020-2024年全球主要国家和地区半导体材料市场规模变化情况 (单位: %)
- 图表61: 2013-2024年全球半导体材料结构竞争格局 (单位: 亿美元)
- 图表62: 2013-2024年全球半导体材料结构情况 (单位: %)
- 图表63: 2024年全球半导体晶圆制造材料市场结构 (单位: %)
- 图表64: 2024年全球半导体封装材料市场结构 (单位: %)
- 图表65: 全球半导体材料行业企业竞争格局 (按主要领域分)
- 图表66: 中国台湾地区主要半导体产业集群
- 图表67: 2014-2024年中国台湾地区半导体材料市场规模情况 (单位: 亿美元)
- 图表68: 2015-2024年中国台湾地区半导体材料市场规模占全球比重变化 (单位: %)
- 图表69: 韩国主要半导体产业集群
- 图表70: 2014-2024年韩国半导体材料市场规模情况 (单位: 亿美元)
- 图表71: 2015-2024年韩国半导体材料市场规模占全球比重变化 (单位: %)
- 图表72: 日本主要半导体产业集群
- 图表73: 2014-2024年日本半导体材料市场规模情况 (单位: 亿美元)
- 图表74: 2015-2024年日本半导体材料市场规模占全球比重变化 (单位: %)
- 图表75: 美国《2022年芯片与科学法案》拨款及用途
- 图表76: 2014-2024年北美地区半导体材料市场规模情况 (单位: 亿美元)
- 图表77: 2015-2024年北美地区半导体材料市场规模占全球比重变化 (单位: %)
- 图表78: 2020-2024年财年日本揖斐电株式会社经营情况 (单位: 亿日元)
- 图表79: 日本揖斐电株式会社半导体材料业务布局
- 图表80: 2019-2024年财年信越化学工业株式会社经营情况 (单位: 亿日元)
- 图表81: 信越化学工业株式会社半导体材料业务布局
- 图表82: 日本信越化学工业株式会社在华投资布局情况
- 图表83: SUMCO公司历史进程
- 图表84: 2019-2024年株式会社SUMCO经营情况 (单位: 亿日元)
- 图表85: 株式会社SUMCO半导体材料业务布局
- 图表86: SUMCO公司硅片规格 (单位: 毫米)
- 图表87: SUMCO公司在华布局情况

图表88: 2019-2024年财年空气化工产品有限公司经营情况 (单位: 亿美元)
图表89: 空气化工产品有限公司半导体材料业务专利技术
图表90: 2020-2024年林德集团 (Linde AG) 营收 (单位: 亿美元)
图表91: 林德集团半导体材料业务布局
图表92: 2025-2030年全球半导体材料行业市场规模预测 (单位: 亿美元)
图表93: 中国半导体材料行业发展历程
图表94: 2014-2024年中国半导体材料市场规模 (单位: 亿美元)
图表95: 2015-2024年中国半导体材料市场规模占全球比重变化 (单位: %)
图表96: 2024年中国大陆主要半导体材料企业竞争情况 (单位: 亿元, %)
图表97: 中国半导体材料行业进出口商品名称及HS编码
图表98: 2019-2024年中国半导体材料进出口概况 (单位: 万吨, 亿美元)
图表99: 2019-2024年中国半导体材料进口情况 (单位: 万吨, 亿美元)
图表100: 2024年中国半导体材料进口产品结构-按金额 (单位: %)
图表101: 2024年中国半导体材料进口产品结构-按数量 (单位: %)
图表102: 2019-2024年中国半导体材料出口情况 (单位: 万吨, 亿美元)
图表103: 2024年中国半导体材料出口产品结构-按金额 (单位: %)
图表104: 2024年中国半导体材料出口产品结构-按数量 (单位: %)
图表105: 半导体材料行业现有企业的竞争分析表
图表106: 半导体材料行业供应商议价能力分析表
图表107: 半导体材料行业消费者议价能力分析表
图表108: 半导体材料行业潜在进入者威胁分析表
图表109: 中国半导体材料行业五力竞争综合分析
图表110: 全球和中国半导体材料细分产品竞争格局 (单位: %)
图表111: 中国半导体材料对外依存度情况
图表112: 截至2024年中国晶圆制造材料国产化进程
图表113: 中国半导体制造工艺及半导体材料的应用
图表114: 2020-2024年中国半导体材料细分市场格局 (单位: %)
图表115: 中国晶圆制造材料细分市场情况
图表116: 中国半导体封装材料细分市场情况
图表117: 区熔法
图表118: 中国单晶硅片行业发展历程分析
图表119: 截至2024年中国半导体硅片行业主要企业产能汇总 (单位: 万片/月)
图表120: 2018-2024年中国半导体硅片市场规模 (单位: 亿美元)
略...完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容, 请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线: 400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件: service@qianzhan.com

或登录网站: <https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务!